Elbląg, dn. 16.11.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/NATIXON/2026

na produkcję i montaż płyt elektronicznych PCB HDI wraz z dostawą modułów COM-HPC, integracją i testem uruchomieniowym – 6 kompletów sprzętowych urządzenia NATIXON Generator/Analizator Ruchu Sieciowego

w ramach projektu nr FEPW.01.01-IP.01-0858/26 pt. „Rozwój i przygotowanie do pierwszej sprzedaży platformy NATIXON – generatora i analizatora ruchu sieciowego dużych przepustowości" współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021–2027, Działanie: Platformy startowe dla nowych pomysłów – Komponent IIa

I. Zamawiający

NATIXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Powstańców Warszawskich 7/2, 82-300 Elbląg
NIP: 7162848221, KRS: 0001175057
osoba do kontaktu: Bartosz Matwiejczyk, tel. 663 730 019, e-mail: bartosz.matwiejczyk@natixon.com
strona www: www.natixon.com

II. Tryb postępowania

1. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności określonej w „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027". Do postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Komunikacja w postępowaniu (pytania, wnioski o udostępnienie dokumentacji, składanie ofert) odbywa się za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, chyba że niniejsze zapytanie stanowi inaczej.
3. Zamawiający nie dzieli zamówienia na części. Przedmiotem zamówienia są kompletne, uruchomione urządzenia (płyta FPGA połączona z płytą nośną z modułem COM-HPC), a podział zamówienia przeniósłby na Zamawiającego ryzyko niekompatybilności modułu z płytą i rozdzieliłby odpowiedzialność za integrację, test uruchomieniowy i gwarancję. Moduły COM-HPC są produktem dostępnym na rynku i Wykonawca może je nabyć jak pozostałe komponenty, w tym za pośrednictwem dostawcy lub podwykonawcy.
4. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych, nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III. Przedmiot zamówienia – informacje ogólne

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 6 kompletów sprzętowych urządzenia NATIXON Generator/Analizator Ruchu Sieciowego. Każdy komplet składa się z: płyty PCB HDI z układem FPGA (zaprojektowanej przez Zamawiającego, wykonywanej przez Wykonawcę), płyty nośnej COM-HPC (dostarczanej przez Zamawiającego, zmontowanej i przetestowanej) oraz modułu procesorowego COM-HPC (zapewnianego przez Wykonawcę). Moduł jest osadzony w złączu COM-HPC płyty nośnej, a płyta nośna jest połączona z płytą FPGA bezpośrednio złączem board-to-board. Komplety są uruchamiane w teście uruchomieniowym.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
   a) produkcję 6 szt. płyt PCB, zakup komponentów, montaż i testy produkcyjne (opis w rozdziale V);
   b) zakup 6 szt. modułów COM-HPC spełniających wymagania określone w rozdziale IV;
   c) montaż modułów COM-HPC na płytach nośnych Zamawiającego, połączenie płyt nośnych z płytami FPGA, test uruchomieniowy oraz dostawę 6 kompletów do Zamawiającego (rozdział V pkt 7).
3. Kody CPV:
   a) główny: 31712300-3 Obwody drukowane;
   b) dodatkowe: 31712310-6 Zbiorcze obwody drukowane; 31710000-6 Sprzęt elektroniczny; 32420000-3 Urządzenia sieciowe; 30230000-0 Sprzęt związany z komputerami.
4. Rodzaj zamówienia: dostawa wraz z usługami produkcji, montażu, testów i integracji. Miejsce realizacji: zakład Wykonawcy (produkcja, montaż, testy, integracja); miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego, ul. Powstańców

Warszawskich 7/2, 82-300 Elbląg, województwo warmińsko-mazurskie, powiat Elbląg (dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy).

IV. Wymagania dla modułów COM-HPC

1. Wykonawca zapewnia 6 szt. fabrycznie nowych modułów COM-HPC, pochodzących od producenta lub autoryzowanego dystrybutora, zgodnych z RoHS, spełniających co najmniej następujące wymagania:
   a) zgodność ze specyfikacją PICMG COM-HPC, typ Server, maksymalnie rozmiar Size D (160 × 160 mm) – płyta nośna Zamawiającego jest zaprojektowana pod moduły do rozmiaru Size D;
   b) procesor z co najmniej 8 zintegrowanymi interfejsami Ethernet 10 Gb/s wyprowadzonymi na złącze modułu zgodnie ze specyfikacją COM-HPC;
   c) pamięć operacyjna co najmniej 64 GB, DDR4 lub nowszej generacji, w komplecie z modułem;
   d) sprzętowe wsparcie wirtualizacji (np. Intel VT-x/VT-d lub równoważne);
   e) co najmniej jeden port PCIe x8 Gen3 lub wyższej generacji wyprowadzony na złącze modułu (do płyty nośnej);
   f) obsługa systemu operacyjnego Linux;
   g) bez radiatora producenta modułu w komplecie;
   h) gwarancja producenta co najmniej 12 miesięcy.
2. Wykonawca nie wskazuje w ofercie modelu modułu COM-HPC. Przed złożeniem zamówienia na moduły Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w formie dokumentowej, producenta i model modułu wraz z kartą katalogową (dopuszczalna w języku angielskim) potwierdzającą spełnienie wymagań z pkt 1. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych potwierdza zgodność modułu z wymaganiami albo wskazuje niezgodności. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do zmiany modelu modułu w trakcie realizacji umowy, przy czym zmiana modelu nie powoduje zmiany wynagrodzenia.
3. Moduły COM-HPC są dostarczane jako element kompletów, po integracji i teście uruchomieniowym (Etap 2, rozdział V pkt 7). Zamawiający nie wymaga ich odrębnej dostawy; termin ich zakupu Wykonawca ustala tak, aby nie opóźniał Etapu 2.

V. Opis przedmiotu zamówienia – płyty PCB, montaż, testy, integracja

1. Zakres prac obejmuje:
   a) przegląd dokumentacji pod kątem wykonalności produkcyjnej (DFM) i przekazanie raportu DFM;
   b) wykonanie płyt PCB HDI w liczbie zapewniającej 6 szt. płyt zmontowanych i sprawnych;
   c) zakup komponentów zgodnie z BOM;
   d) montaż SMT/THT wszystkich 6 płyt w jednej serii produkcyjnej, testy produkcyjne i kontrolę jakości;
   e) zakup 6 szt. modułów COM-HPC (rozdział IV), montaż modułów na płytach nośnych Zamawiającego, połączenie płyt nośnych z płytami FPGA, test uruchomieniowy oraz dostawę 6 kompletów do Zamawiającego.

Dokumentacja produkcyjna i ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

2. Dokumentacja produkcyjna (pliki Gerber/ODB++, wiercenia, stackup i tabela impedancji, rysunek fabrykacyjny, BOM wraz z listą dopuszczonych producentów, pliki Pick&Place, rysunki montażowe, specyfikacja testów i procedura testu uruchomieniowego, dokumentacja mechaniczna i specyfikacja elektryczna płyty nośnej COM-HPC oraz złącza board-to-board) stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego i jest udostępniana wyłącznie po zawarciu umowy o zachowaniu poufności (NDA) według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7.
3. Wniosek o udostępnienie dokumentacji należy przekazać za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, w miarę możliwości w terminie wskazanym w harmonogramie (rozdział VI). Zamawiający przekaże wzór NDA do podpisu (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty lub skan dokumentu podpisanego odręcznie przez osobę uprawnioną) i udostępni dokumentację w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania podpisanej umowy, poprzez zabezpieczony link. Wszyscy wykonawcy otrzymują tę samą wersję dokumentacji; w razie jej zmiany Zamawiający przekaże nową wersję wszystkim wykonawcom, którzy zawarli NDA. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego dokumentacja zostanie udostępniona później albo zostanie zmieniona, Zamawiający w razie potrzeby przedłuży termin składania ofert. Złożenie podpisanego NDA nie jest warunkiem ważności oferty; wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zawiera NDA najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Podstawowe parametry (informacje jawne)

4. Podstawowe parametry płyty FPGA (pełne parametry, w tym stackup, tabelę impedancji i BOM, zawiera dokumentacja produkcyjna – pkt 2):

a) płyta PCB HDI (mikroprzelotki laserowe, przelotki ślepe i zagrzebane, laminacja sekwencyjna, via-in-pad wypełnione i pokryte), 26 warstw, wymiary 200 × 180 mm, grubość 3 mm, wykończenie ENEPIG, impedancja kontrolowana (weryfikacja TDR na kuponach testowych), wykonanie wg IPC-6012 klasa 2;

b) laminat Panasonic Megtron 7N lub równoważny, tj. laminat niskostratny o parametrach nie gorszych niż: Dk ≤ 3,4 i Df ≤ 0,002 przy częstotliwości 10–14 GHz, Tg ≥ 200°C (DSC) – wartości typowe wg karty katalogowej producenta; laminat równoważny Wykonawca proponuje w raporcie DFM wraz z kartą katalogową i przeliczonym stackupem, a jego zastosowanie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, przy zachowaniu tabeli impedancji;

c) montaż dwustronny SMT oraz THT (bez elementów wciskanych press-fit), ok. 3134 komponenty na płytę (nie więcej niż 140 pozycji BOM), w tym układ BGA ok. 2500 kulek o rastrze 1 mm, najmniejsze elementy pasywne 0201; montaż bezołowiowy zgodny z RoHS, jakość wg IPC-A-610 klasa 2.

5. Wykonawca zapewnia wszystkie komponenty zgodnie z BOM – fabrycznie nowe, zgodne z RoHS, pochodzące od producentów lub autoryzowanych dystrybutorów. Zamawiający nie powierza Wykonawcy komponentów; jedynym mieniem powierzonym są płyty nośne (pkt 10). Zamienniki komponentów oraz zmiany laminatu lub stackupu wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego w formie dokumentowej. Wykonawca przestrzega wymagań MSL i ochrony ESD.

Etapy realizacji i testy

6. **Etap 1 – DFM, produkcja PCB, zakup komponentów, montaż i testy 6 płyt.** Termin: zgodnie z ofertą, nie dłużej niż 9 tygodni od dnia zawarcia umowy. Zakres:

   a) raport DFM w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy; Zamawiający odpowiada w ciągu 3 dni roboczych;

   b) wykonanie płyt PCB wraz z testem elektrycznym 100%, pomiarem impedancji TDR na kuponach testowych i certyfikatem zgodności (CoC);

   c) montaż wszystkich 6 płyt w jednej serii produkcyjnej, po zatwierdzeniu raportu DFM, oraz testy każdej płyty: AOI, X-ray 100% układów BGA, flying probe lub ICT oraz inspekcja wizualna;

   d) zgłoszenie zakończenia Etapu 1 wraz z raportami z testów każdej płyty.

7. **Etap 2 – integracja i test uruchomieniowy.** Termin: do 1 tygodnia od późniejszego z dwóch zdarzeń: zgłoszenia zakończenia Etapu 1 wraz z raportami z testów albo dostarczenia płyt nośnych COM-HPC przez Zamawiającego (pkt 10). Termin Etapu 2 ulega odpowiedniemu przedłużeniu w przypadku wystąpienia problemów projektowych, programowych, konfiguracyjnych lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, o czas niezbędny do ich usunięcia. Zakres:

   a) montaż modułów COM-HPC zapewnionych przez Wykonawcę na płytach nośnych dostarczonych przez Zamawiającego oraz połączenie każdej płyty nośnej z płytą FPGA złączem board-to-board, bez dodatkowych elementów łączących (złącze po stronie płyty FPGA jest pozycją BOM płyty FPGA, złącze po stronie płyty nośnej jest na niej zamontowane);

   b) test uruchomieniowy (Power-On / Functional Smoke Test) każdego kompletu według procedury Zamawiającego: weryfikacja napięć zasilających, start modułu COM-HPC i systemu operacyjnego, konfiguracja układu FPGA, potwierdzenie łącza PCIe co najmniej x8 Gen3 pomiędzy modułem a FPGA oraz test komunikacji pomiędzy kompletami. Test odbywa się w zakładzie Wykonawcy z udziałem przedstawiciela Zamawiającego (osobiście lub zdalnie), w terminie uzgodnionym z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych. Zamawiający zapewnia, najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem Etapu 2, procedurę testu, obrazy oprogramowania i konfiguracji FPGA, nośniki systemu, programator, kable i moduły do testu komunikacji; Wykonawca zapewnia stanowisko z ochroną ESD, zasilacz laboratoryjny, przyrządy pomiarowe i personel;

   c) dostawa 6 kompletów do Zamawiającego w opakowaniach ESD.

8. Przedmiotem zamówienia nie jest opracowanie projektu płyty FPGA ani płyty nośnej ani testy funkcjonalne wykraczające poza test uruchomieniowy z pkt 7, w szczególności pełna funkcjonalność oprogramowania i testy przepustowości. Przegląd DFM nie oznacza przyjęcia przez Wykonawcę odpowiedzialności za poprawność rozwiązań projektowych; w raporcie DFM Wykonawca zgłasza zauważone błędy, braki i ryzyka technologiczne dokumentacji. Wykonawca nie odpowiada za wady projektowe, tj. wady kompletu wykonanego zgodnie z dokumentacją, których przyczyna tkwi wyłącznie w dokumentacji, w oprogramowaniu lub konfiguracji FPGA dostarczonych przez Zamawiającego albo w płycie nośnej. Zakwalifikowanie wady jako wady projektowej wymaga wykazania przez Wykonawcę, w formie dokumentowej, że komplet został wykonany zgodnie z dokumentacją, oraz wskazania przyczyny wady; pozostałe wady, w szczególności wynikające z wykonania PCB, materiałów, komponentów, montażu, testów lub integracji, obciążają Wykonawcę. W razie ujawnienia wady, która może stanowić wadę projektową, Wykonawca niezwłocznie powiadamia Zamawiającego i przedstawia analizę jej przyczyny, a Zamawiający przekazuje poprawioną dokumentację; termin może zostać przedłużony na zasadach rozdziału XIV pkt 14 lit. b. Jeżeli test

uruchomieniowy nie powiedzie się z przyczyn leżących po stronie płyty nośnej, Wykonawca niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego, przedstawiając wyniki testu; Zamawiający niezwłocznie wymienia płytę nośną, a termin Etapu 2 przedłuża się o czas wymiany.

9. Dokumenty przekazywane przy zgłoszeniu zakończenia etapu (w formie dokumentowej): po Etapie 1 – raport DFM, CoC i raporty TDR płyt PCB oraz raporty z testów każdej płyty FPGA (pkt 6 lit. c); po Etapie 2 – protokoły testu uruchomieniowego każdego kompletu, zestawienie numerów seryjnych płyt FPGA, płyt nośnych i modułów COM-HPC oraz dokumenty gwarancyjne producenta modułów. Raporty wskazują badany egzemplarz. Wykonawca wyznacza osobę kontaktową i niezwłocznie informuje Zamawiającego o zagrożeniu dotrzymania terminu.
10. Płyty nośne COM-HPC: Zamawiający dostarczy na swój koszt do zakładu Wykonawcy (adres wskazany w umowie) 6 szt. zmontowanych i przetestowanych płyt nośnych COM-HPC, nie później niż do 15.01.2027 r. Przekazanie płyt nośnych potwierdza protokół wskazujący liczbę sztuk, numery seryjne i ewentualne widoczne uszkodzenia. Płyty nośne pozostają własnością Zamawiającego; od chwili ich przyjęcia do dostawy kompletów Wykonawca przechowuje je z zachowaniem ochrony ESD, wykorzystuje wyłącznie do wykonania umowy i odpowiada za ich utratę lub uszkodzenie jak za mienie powierzone. Dokumentacja mechaniczna i specyfikacja elektryczna płyty nośnej oraz złącza board-to-board jest udostępniana wraz z dokumentacją produkcyjną (pkt 2).

VI. Harmonogram

1. Planowany przebieg postępowania:

Czynność	Termin
Publikacja zapytania w Bazie Konkurencyjności	16.11.2026
Zalecany termin wniosków o dokumentację (NDA)	do 19.11.2026
Termin zadawania pytań z gwarancją odpowiedzi	do 4 dni przed terminem składania ofert
Termin składania ofert	24.11.2026, godz. 10:00
Planowane rozstrzygnięcie	25.11.2026
Planowane zawarcie umowy	do 30.11.2026

2. Terminy realizacji (liczone od dnia zawarcia umowy, o ile nie wskazano inaczej):

Etap	Termin maksymalny
Etap 1 – DFM, PCB, komponenty, montaż i testy 6 płyt	wg oferty, nie dłużej niż 9 tygodni (kryterium oceny)
Dostarczenie płyt nośnych COM-HPC przez Zamawiającego	do 15.01.2027
Etap 2 – integracja z modułami COM-HPC, test uruchomieniowy, dostawa 6 kompletów	1 tydzień od późniejszego z dwóch zdarzeń: zgłoszenia zakończenia Etapu 1 albo dostarczenia płyt nośnych; przedłużenie w przypadkach wskazanych w rozdziale V pkt 7–8
Termin końcowy – dostawa 6 kompletów	**wynika z terminów Etapu 1 i Etapu 2 (pkt 3)**

3. Termin końcowy realizacji całości zamówienia (dostawa 6 kompletów po teście uruchomieniowym) wynika z terminów realizacji Etapu 1 i Etapu 2 określonych w pkt 2, z uwzględnieniem dopuszczalnych przesunięć terminów przewidzianych w rozdziale V pkt 7–8 oraz w rozdziale XIV pkt 14. Terminy realizacji mogą zostać zmienione wyłącznie w tych przypadkach.

VII. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu (rozdział VIII) oraz spełniają warunki określone w pkt 2. Zamawiający nie określa warunków dotyczących dostaw modułów COM-HPC ani warunków w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności lub czynności oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2. Warunki udziału w postępowaniu:
   a) **Doświadczenie:** w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie wykonali – samodzielnie lub z udziałem podwykonawców – co najmniej 2 usługi obejmujące produkcję i montaż SMT wielowarstwowych płyt PCB z układami BGA;

b) **Potencjał techniczny:** dysponują – własnym lub podwykonawców – zapleczem umożliwiającym produkcję płyt PCB HDI o liczbie warstw co najmniej 26 z kontrolą impedancji (TDR), montaż SMT układów BGA, inspekcję X-ray i AOI oraz test flying probe lub ICT;

c) **Osoby:** dysponują – samodzielnie lub poprzez podwykonawców – co najmniej: (i) kierownikiem projektu z co najmniej 2-letnim doświadczeniem zawodowym w zarządzaniu projektami elektronicznymi lub EMS, w tym z etapami: PCB, montaż, testy; (ii) inżynierem ds. uruchamiania i integracji z co najmniej 2-letnim doświadczeniem zawodowym w uruchamianiu i testowaniu urządzeń elektronicznych z układami FPGA lub modułami procesorowymi (np. COM-HPC, COM Express), w tym w weryfikacji połączeń PCIe i przeprowadzaniu testów Power-On. Zamawiający dopuszcza pełnienie obu funkcji przez jedną osobę.

3. Sposób potwierdzenia spełnienia warunków:

   a) warunek z pkt 2 lit. a – Wykaz zrealizowanych usług (Załącznik nr 2) oraz Wykaz referencji (Załącznik nr 6) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług (pisma referencyjne, protokoły odbioru, faktury z opisem zakresu lub inne dokumenty wystawione przez odbiorcę) albo oświadczeniem własnym wykonawcy o ich należytym wykonaniu; Zamawiający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia;

   b) warunek z pkt 2 lit. b – oświadczenie w Formularzu oferty (Załącznik nr 1);

   c) warunek z pkt 2 lit. c – Wykaz osób (Załącznik nr 3) wraz z CV wskazanych osób (Załącznik nr 4 lub CV według własnego wzoru o tożsamym zakresie).

4. Wykonawca może spełniać warunki z pkt 2 samodzielnie lub z udziałem podwykonawców; w wykazach (Załączniki nr 2, 3 i 6) może wskazać usługi wykonane z udziałem podwykonawców oraz osoby, którymi dysponują podwykonawcy. Zamawiający nie wymaga wskazywania podwykonawców w ofercie ani składania przez nich odrębnych zobowiązań.

5. Ocena spełnienia warunków dokonywana jest według formuły „spełnia / nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów.

VIII. Podstawy wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

   a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

   b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

   c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

2. Z postępowania wyklucza się wykonawców, wobec których zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, a także wykonawców, wobec których zachodzi zakaz, o którym mowa w art. 5k lub 5l rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie bez udziału podmiotów, o których mowa w art. 5k ust. 1 tego rozporządzenia, w tym podwykonawców i dostawców, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości umowy.

3. Brak podstaw wykluczenia wykonawca potwierdza oświadczeniami zawartymi w Formularzu oferty.

IX. Kryteria oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiający stosuje kryteria: cena – 80%, termin realizacji Etapu 1 – 20%.

2. Sposób przyznawania punktów:

   a) Cena (C) – 80%: C = (Cmin / Cbad) × 80, gdzie Cmin – najniższa cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Cbad – cena brutto badanej oferty;

b) Termin realizacji Etapu 1 (T) – 20%, liczony w pełnych tygodniach od dnia zawarcia umowy: 9 tygodni – 0 pkt; 8 tygodni – 10 pkt; 7 tygodni lub krócej – 20 pkt. Wskazanie terminu dłuższego niż 9 tygodni powoduje odrzucenie oferty; brak wskazania terminu oznacza przyjęcie terminu 9 tygodni.

c) Łączna liczba punktów: P = C + T.

3. Obliczenia dokonywane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie tych wykonawców do złożenia ofert dodatkowych zawierających nową cenę, nie wyższą niż w ofercie pierwotnej. Zamawiający nie prowadzi negocjacji.
5. W przypadku oferty, której złożenie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (np. import usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów), Zamawiający w celu oceny doliczy do ceny netto podatek VAT, który byłby obowiązany rozliczyć.

X. Sposób przygotowania oferty

1. Ofertę sporządza się na Formularzu oferty (Załącznik nr 1), w języku polskim. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług mogą być złożone w języku angielskim.
2. Cena ma charakter ryczałtowy, jest wyrażona w złotych polskich (netto, VAT, brutto) i obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym moduły COM-HPC, komponenty, materiały, narzędzia (NRE), testy, transport, ubezpieczenie, opakowania i przechowywanie płyt nośnych, a także licencję, o której mowa w rozdziale XIV pkt 21. Cena nie podlega waloryzacji. Cenę podaje się w podziale na pozycje wskazane w Formularzu oferty.
3. Oferta obejmuje:
   a) Formularz oferty (Załącznik nr 1);
   b) Wykaz zrealizowanych usług (Załącznik nr 2);
   c) Wykaz osób (Załącznik nr 3) wraz z CV wskazanych osób (Załącznik nr 4);
   d) Wykaz referencji (Załącznik nr 6) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług albo oświadczeniem własnym wykonawcy;
   e) pełnomocnictwo – jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik.
4. Zamawiający samodzielnie pobierze odpis z KRS lub wydruk z CEIDG. Wykonawca zagraniczny załącza równoważny dokument rejestrowy.
5. Ofertę podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji wykonawcy: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo w postaci skanu dokumentu podpisanego odręcznie.
6. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa, z wyjątkiem nazwy, ceny i terminu realizacji, wydzielając je w osobnym pliku i wykazując ich charakter.
7. Załącznik nr 5 (klauzula informacyjna RODO) ma charakter informacyjny i nie wymaga podpisu.

XI. Miejsce, termin i sposób składania ofert

1. Oferty składa się wyłącznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, w formie plików uniemożliwiających edycję (np. PDF), w terminie do dnia 24.11.2026 r., godz. 10:00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Przed upływem terminu wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.
3. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

XII. Wyjaśnienia i zmiany treści zapytania

1. Pytania dotyczące treści zapytania należy zadawać za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że pytanie wpłynęło nie później niż na 4 dni przed upływem tego terminu. Na pytania złożone później Zamawiający może odpowiedzieć albo pozostawić je bez rozpoznania.
2. Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiający publikuje w Bazie Konkurencyjności, bez wskazania źródła zapytania.
3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania. Informację o zmianie publikuje w Bazie Konkurencyjności, a jeżeli zmiana wymaga czasu na dostosowanie ofert – przedłuża termin składania ofert.

XIII. Badanie ofert

1. Zamawiający jednokrotnie wezwie wykonawcę do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału lub brak podstaw wykluczenia, w wyznaczonym terminie, chyba że oferta podlega odrzuceniu z innych przyczyn. Uzupełnienie nie może prowadzić do zmiany ceny, terminu ani zakresu oferty.
2. Zamawiający może żądać wyjaśnień treści oferty oraz poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.
3. Jeżeli cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o VAT lub od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający wezwie wykonawcę do wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny. Oferta wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub którego wyjaśnienia potwierdzają rażąco niską cenę, zostanie odrzucona.
4. Zamawiający odrzuca ofertę, która: została złożona po terminie; jest niezgodna z treścią zapytania; została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału lub podlegającego wykluczeniu; zawiera rażąco niską cenę; zawiera nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania.

XIV. Istotne postanowienia umowy

Zawarcie umowy

1. Zamawiający nie załącza do zapytania wzoru umowy. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej na warunkach określonych w zapytaniu, w szczególności w niniejszym rozdziale, oraz w ofercie wybranego Wykonawcy; projekt umowy Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy przed jej zawarciem. Złożenie oferty oznacza akceptację istotnych postanowień umowy określonych w niniejszym rozdziale.

Płatności

2. Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ceny oferty, w podziale na pozycje 1–3 Formularza oferty. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania umowy, w tym moduły COM-HPC, komponenty, materiały, narzędzia (NRE), testy, transport, ubezpieczenie, opakowania i przechowywanie płyt nośnych, a także licencję, o której mowa w pkt 21. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
3. Części wynagrodzenia:
   a) na wniosek Wykonawcy zgłoszony w Formularzu oferty – zaliczka w wysokości 100% wynagrodzenia brutto za pozycje 1 i 2 Formularza (moduły COM-HPC oraz płyty PCB wraz z komponentami, montażem i testami), płatna w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie faktury zaliczkowej;
   b) wynagrodzenie za pozycję 2 Formularza, jeżeli nie została opłacona zaliczką – po odbiorze Etapu 1;
   c) wynagrodzenie za pozycję 3 Formularza (integracja, test uruchomieniowy, dostawa) oraz za pozycję 1, jeżeli nie została opłacona zaliczką – po odbiorze końcowym.
4. Płatności następują w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ujawniony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, jeżeli wymagają tego przepisy. Faktura, inna niż zaliczkowa, może zostać wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru danego etapu. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Opóźnienie Zamawiającego w zapłacie zaliczki stanowi przyczynę leżącą po stronie Zamawiającego (pkt 14 lit. b). Przelew wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
5. W przypadku odstąpienia od umowy strony dokonują wspólnej inwentaryzacji stanu realizacji umowy, obejmującej wykonane i odebrane etapy, prace w toku, zakupione lub zamówione komponenty, materiały, moduły COM-HPC oraz wyprodukowane lub będące w produkcji płyty PCB. Na podstawie inwentaryzacji strony rozliczają się według faktycznego stanu zaawansowania prac oraz udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w tym zobowiązań wobec dostawców i podwykonawców, których nie można anulować. Zamawiający pokrywa wartość wykonanych prac oraz uzasadnionych i udokumentowanych kosztów związanych z realizacją umowy, z uwzględnieniem dotychczasowych płatności. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu rozliczone materiały, komponenty i rezultaty prac, a ewentualna nadpłata podlega zwrotowi Zamawiającemu. Strony podejmują uzasadnione działania w celu ograniczenia kosztów związanych z odstąpieniem od umowy.

Odbiory

6. Wykonawca zgłasza zakończenie etapu w formie dokumentowej, przekazując dokumenty wskazane w rozdziale V pkt 9. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od kompletnego zgłoszenia dokonuje odbioru albo zgłasza wady. Wady istotne uniemożliwiają odbiór; wady nieistotne wpisuje się do protokołu wraz z terminem ich usunięcia. Odbiór Etapu

1 następuje na podstawie raportów z testów i nie wstrzymuje rozpoczęcia Etapu 2. Odbiór końcowy następuje po dostawie 6 kompletów do siedziby Zamawiającego. Wykonawca usuwa wady na własny koszt i ponownie zgłasza etap do odbioru wraz z wynikami powtórnych testów. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia kompletów przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego. Protokoły odbioru sporządza Zamawiający.

Kary umowne i odstąpienie od umowy

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
   a) za zwłokę w terminie Etapu 1 lub Etapu 2 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki;
   b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki ponad uzgodniony termin;
   c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.
8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem odstąpienia, o którym mowa w pkt 12.
9. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto. Kary nie przysługują za zwłokę wynikającą z okoliczności, o których mowa w pkt 14 lit. a–c. Kary umowne są płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty; Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.
10. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych, przy czym łączna odpowiedzialność Wykonawcy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia brutto i nie obejmuje utraconych korzyści, z wyjątkiem szkody wyrządzonej umyślnie.
11. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zwłoka Wykonawcy przekracza 30 dni, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego na piśmie, nie krótszego niż 7 dni; prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie 60 dni od upływu dodatkowego terminu. Do okresu zwłoki nie wlicza się opóźnień wynikających z przyczyn określonych w pkt 14 lit. a–c, w szczególności opóźnień produkcji lub dostaw PCB, komponentów i modułów COM-HPC, niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem ich udokumentowania.
12. Zamawiający może odstąpić od umowy bez obowiązku zapłaty kary umownej w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu lub wstrzymania jego finansowania, w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej okoliczności. W takim przypadku Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za część umowy wykonaną do dnia odstąpienia oraz udokumentowane koszty zamówionych komponentów i materiałów, których zamówień nie można było anulować, w zamian za wydanie tych przedmiotów.
13. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej z uzasadnieniem. W razie odstąpienia Wykonawca niezwłocznie zwraca Zamawiającemu płyty nośne i dokumentację, a strony rozliczają się na zasadach określonych w pkt 5.

Zmiany umowy

14. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy wyłącznie w następującym zakresie:
   a) przedłużenie terminu o czas trwania siły wyższej i usuwania jej skutków;
   b) przedłużenie terminu o czas opóźnienia wynikającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności przekazania dokumentacji albo płyt nośnych (w tym ich wymiany), zmiany dokumentacji, przekroczenia terminu odpowiedzi na raport DFM lub na propozycję modułu COM-HPC (rozdział IV pkt 2) albo opóźnienia w zapłacie zaliczki;
   c) przedłużenie terminu w przypadku udokumentowanej niedostępności komponentów, modułów COM-HPC lub laminatu, a także opóźnień w produkcji lub dostawie PCB, komponentów i modułów, wynikających z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności przesunięcia terminów przez producentów lub dostawców – o rzeczywisty czas trwania tych okoliczności i ich skutków, bez ograniczenia do 30 dni. Opóźnienia te nie stanowią zwłoki Wykonawcy i nie mogą być podstawą naliczania kar umownych ani odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
   d) zastosowanie zamiennika komponentu zatwierdzonego przez Zamawiającego – bez zmiany wynagrodzenia;
   e) zmiana stawki VAT – wynagrodzenie brutto zmienia się odpowiednio, wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian;
   f) zmiany nieistotne, w tym danych stron, osób kontaktowych i oczywistych omyłek.
15. Strona wnioskująca o zmianę przedstawia jej uzasadnienie wraz z dowodami, a w przypadku, o którym mowa w pkt 14 lit. c – potwierdzenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora. Zmiana terminu nie może wykraczać poza

okres realizacji projektu określony w umowie o dofinansowanie. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

16. Umowa przewiduje ponadto: przedłużenie terminu Etapu 2 w przypadkach, o których mowa w rozdziale V pkt 7 i 8, oraz możliwość zmiany osób wskazanych w Wykazie osób (Załącznik nr 3), przy udziale których Wykonawca realizuje umowę, na osoby spełniające warunki określone w rozdziale VII pkt 2 lit. c, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego.

Gwarancja

17. Moduły COM-HPC: gwarancja producenta modułu, nie krótsza niż 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego; Wykonawca przyjmuje zgłoszenia gwarancyjne i pośredniczy w ich obsłudze u producenta.
18. Komplety: gwarancja Wykonawcy na okres 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego, obejmująca wady wykonania płyt PCB, wady montażu i integracji (w tym montażu modułów COM-HPC na płytach nośnych i połączenia z płytami FPGA) oraz wady komponentów zakupionych przez Wykonawcę. Gwarancja nie obejmuje wad projektowych (rozdział V pkt 8), płyt nośnych ani uszkodzeń powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
19. Wykonawca potwierdza przyjęcie zgłoszenia w ciągu 2 dni roboczych, przedstawia diagnozę w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania płyty FPGA lub kompletu i usuwa wadę w ciągu 20 dni roboczych. Jeżeli usunięcie wady wymaga ponownego wykonania płyty PCB, strony uzgadniają termin nie dłuższy niż termin Etapu 1 wskazany w ofercie. Koszty napraw, wymiany, ponownych testów i transportu w ramach gwarancji ponosi Wykonawca. Diagnoza jest wykonywana w ramach gwarancji także wtedy, gdy wykaże wadę projektową; usunięcie wady projektowej nie należy do obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy. Zgłoszenia gwarancyjne są przekazywane na adres e-mail Wykonawcy wskazany w umowie; Wykonawca dokumentuje każdą naprawę, wskazując egzemplarz, zakres usuniętej wady i wyniki testów po naprawie.

Poufność i prawa do rezultatów

20. Dokumentacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego. Do informacji przekazanych w związku z umową stosuje się umowę o zachowaniu poufności zawartą według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7, przy czym obowiązek poufności trwa nie krócej niż 5 lat od dnia wykonania umowy. Wykonawca nie wykorzystuje dokumentacji ani konstrukcji Zamawiającego do produkcji na rzecz osób trzecich ani do publikacji, prezentacji lub działań marketingowych bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. Po wykonaniu umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego zwraca lub usuwa dokumentację, z wyjątkiem kopii niezbędnych do realizacji gwarancji oraz tych, których przechowywanie jest wymagane przepisami prawa.
21. Z chwilą odbioru danego etapu Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji na korzystanie z raportów, protokołów, przeliczonego stackupu i innych dokumentów przekazanych w ramach umowy, w zakresie potrzebnym do produkcji, serwisu, certyfikacji i sprzedaży urządzeń, z prawem udzielania sublicencji w tym zakresie. Narzędzia, biblioteki i know-how Wykonawcy istniejące przed zawarciem umowy lub opracowane niezależnie od niej pozostają własnością Wykonawcy.

Pozostałe

22. Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy podwykonawcom, odpowiadając za ich działania i zaniechania jak za własne, pod warunkiem objęcia ich obowiązkiem zachowania poufności na poziomie nie niższym niż określony w umowie o zachowaniu poufności. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca informuje o podwykonawcach, którym powierzył wykonanie części umowy. Wykonawca realizuje umowę bez udziału podmiotów, o których mowa w art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014, w tym podwykonawców i dostawców, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości umowy.
23. Wykonawca udostępnia dokumenty związane z wykonaniem umowy instytucjom uprawnionym do kontroli projektu, w szczególności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, umożliwia przeprowadzenie przewidzianych prawem kontroli oraz niezwłocznie informuje Zamawiającego o zmianie oświadczeń złożonych w ofercie. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego; spory rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. W razie rozbieżności pierwszeństwo mają kolejno: zapytanie, umowa, oferta, dokumentacja.

XV. Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli:
   a) nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty podlegają odrzuceniu;
   b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty;

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, której nie można było wcześniej przewidzieć, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;

d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy;

e) nastąpiło rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu lub wstrzymanie jego finansowania.

2. Informację o unieważnieniu wraz z uzasadnieniem Zamawiający publikuje w Bazie Konkurencyjności.

XVI. Informacja o wyniku postępowania

1. Informację o wyniku postępowania, zawierającą nazwę i siedzibę wybranego wykonawcy oraz cenę wybranej oferty, Zamawiający publikuje w Bazie Konkurencyjności.
2. Jeżeli wybrany wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną najwyżej ocenioną ofertę.

XVII. Ochrona danych osobowych

1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 5.

XVIII. Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Wykaz zrealizowanych usług
3. Załącznik nr 3 – Wykaz osób
4. Załącznik nr 4 – Wzór CV
5. Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna RODO
6. Załącznik nr 6 – Wykaz referencji
7. Załącznik nr 7 – Wzór umowy o zachowaniu poufności (NDA)